

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年8月4日(04.08.2022)



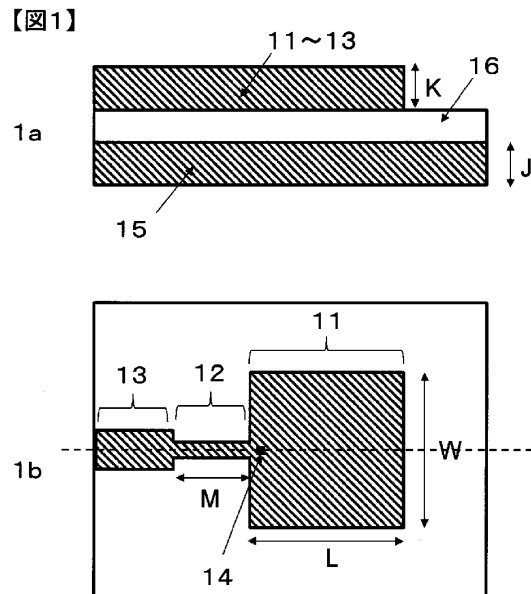
(10) 国際公開番号

WO 2022/163335 A1

- (51) 国際特許分類:
C07C 275/14 (2006.01) G03F 7/027 (2006.01)
C08F 265/00 (2006.01) G03F 7/032 (2006.01)
C08F 283/00 (2006.01) G03F 7/033 (2006.01)
H01L 23/12 (2006.01) G03F 7/037 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01) G03F 7/075 (2006.01)
G03F 7/004 (2006.01) H01L 21/312 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/000472
- (22) 国際出願日: 2022年1月11日(11.01.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-010013 2021年1月26日(26.01.2021) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 壽慶将也(JUKEI, Masaya); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 小笠原央(OGASAWARA, Hisashi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 荒木斉(ARAKI, Hitoshi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, CURED FILM, ELECTRONIC COMPONENT, ANTENNA ELEMENT, SEMICONDUCTOR PACKAGE, AND COMPOUND

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、硬化膜、電子部品、アンテナ素子、半導体パッケージおよび化合物



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a photosensitive resin composition and compound having a low dielectric loss tangent when made into a cured film. The present invention is a photosensitive resin composition containing (A) a polyfunctional monomer, (B) a binder resin, and (C) a photopolymerization initiator, the (A) polyfunctional monomer containing a compound represented by formula (1) and/or a compound represented by formula (2),

[続葉有]

WO 2022/163335 A1

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

and the (B) binder resin containing one or more substances selected from the group consisting of polyimides, polyimide precursors, polybenzoxazoles, polybenzoxazole precursors, polyamides, copolymers thereof, polyureas, polyesters, polysiloxanes, acrylic resins, phenol resins and benzocyclobutene resins, and maleic acid resins and cycloolefin polymers.

(57) 要約: 本発明は、硬化膜としたときに低誘電正接を有する感光性樹脂組成物および化合物を提供することを目的とする。本発明は、(A) 多官能モノマー、(B) バインダー樹脂および(C) 光重合開始剤を含有する感光性樹脂組成物であって、該(A) 多官能モノマーが、式(1)で表される化合物および/または式(2)で表される化合物を含有し、該(B) バインダー樹脂が、ポリイミド、ポリイミド前駆体、ポリベンゾオキサゾール、ポリベンゾオキサゾール前駆体、ポリアミド、それらの共重合体、ポリウレア、ポリエステル、ポリシロキサン、アクリル樹脂、フェノール樹脂およびベンゾシクロブテン樹脂、マレイン酸樹脂およびシクロオレフィンポリマーからなる群より選択される1種類以上を含有する感光性樹脂組成物である。